

緊急経営施策及び新たな連結経営について

日立製作所は、中期経営計画「i.e.HITACHI プラン」の実現に向けて、1999年4月からスタートした新経営体制の下で事業構造の転換や経営改革を実行してきましたが、今般、市場環境の急変による業績悪化を踏まえ、業績の早期改善を図るべく更なる緊急経営施策を実施します。

また、企業間競争が熾烈になる中で、日立グループの企業価値を加速度的に増大していくためには本格的な連結経営の展開が不可避であるとの認識に立ち、本年度下期からは、日立グループ本社機能を強化し、新たに日立独自の付加価値評価指標「F I V (Future Inspiration Value)」の導入により新セグメント単位での事業ポートフォリオを再評価します。その上で、日立グループのあるべき姿を明確にするとともに、事業戦略を抜本的に見直し、この方針に基づいた事業再編を断行していきます。

．緊急経営施策

[1] 全社的緊急施策

1．固定費の抜本的削減

個別ベースでは、事業グループ毎に固定費の削減目標を設定し、本年度末までに年間の固定費水準を全社で600億円削減します。

子会社においても、電子デバイス、高機能材料などの業績悪化の顕著な部門を中心に生産拠点の整理統合、人員削減等による固定費の削減を進め、連結ベースでは約1,300億円の削減を目指します。

2．人員削減

人員については、連結ベースでは、自然減等の他、半導体グループ、ディスプレイグループを中心とした事業再構築等により、本年度末までに約14,700人（国内10,200人、海外4,500人）を削減します。

3．設備投資計画の抜本的見直し

急激な経営環境の悪化に対応するため、設備投資は原則凍結とし、合理化・原価低減など、最低限必要な投資案件に絞り込みます。

なお、供給過剰の状態が著しい半導体事業においては、当初予定の1,400億円を600億円に削減し、キャッシュフローの悪化防止に努めます。

4. 経営効率の向上

以下に示すコーポレート・イノベーション・イニシアチブ(CII)を着実に実行、推進します。

調達リニューアルプロジェクト(PPR)

日立グループの調達仕様・方法の見直し、ネット集中購買の積極活用、物流コストの大幅低減を軸に、連結ベースでの資材調達コストを2年間で20%(約6,000億円)削減する計画であり、本年度上期においては、計画を上回る成果を挙げています。

Cプロジェクト

戦略投資資金の確保、有利子負債の圧縮を図るべく、「棚卸資産」と「売掛債権」の手持ち日数を2003年3月末までに25%短縮(2000年9月末比)し、キャッシュフロー1兆円の改善を図ります。

現在、2001年9月末時点で、「棚卸資産」と「売掛債権」の手持ち日数の約10%短縮(2000年9月末比)を目標に推進中です。

A計画

各事業グループ・各部門において、2~3年以内に世界のトップ集団を走る事業及び業務を育成する計画を戦略的に推進中です。本計画の対象製品、サービスについては、2000年度の売上規模を、2001年度には1.5倍に、2002年度には2倍に拡大していきます。

[2] 事業グループ緊急施策

1. 半導体事業

事業の選択と集中

日立が強みを有し、かつ市場規模が大きい、もしくは、成長性が高い製品・分野に経営資源を集中します。さらに、事業ポートフォリオを、汎用品を多数のお客様に提供する汎用品ビジネスと、モバイル、車載情報システム等、特定分野におけるリーダー企業のニーズに対応したソリューションや応用製品を提供していく分野対応ビジネスで構成していきます。

<汎用品ビジネス>

汎用半導体、汎用マイコン、システムメモリの中で注力製品群を選択し、選択後の製品ラインアップの強化により市場のカバー範囲を拡大します。

<分野対応ビジネス>

モバイル・ネットワーク、デジタル民生機器、車載情報システムのマーケットの中で注力分野を選択し、リーダー企業のニーズに対応したシステムソリューションや応用品マイコン、システムLSI等の応用製品を集中的に投入することでシェア拡大を図ります。

事業体制の再構築

- ・汎用半導体部門の一部と日立東部セミコンダクタ(株)を統合し、汎用半導体の営業・設計・製造一貫会社を2002年度中に設立、開発能力の強化とコスト低減を実現

します。

- ・汎用マイコン部門の一部と日立北海セミコンダクタ㈱を中心とした汎用マイコンの設計・製造一貫体制を本年10月を目処に整備し、収益向上を図ります。
- ・最先端プロセスと300ミリウェハによる生産効率に優れたトレセンティテクノロジーズ㈱に、高性能かつ短納期、低コスト化が特に要求されるシステムLSIやフラッシュメモリ、SRAMを投入することで稼働率を向上させ、収益改善を図ります。

業績改善施策

- ・前工程については、既に凍結している甲府地区の一部の製造ラインに加え、那珂地区、甲府地区、高崎地区、小平地区、日立北海セミコンダクタ㈱においても稼働率の低いラインの生産を一時凍結し、19ラインから13ライン体制とします。
- ・後工程については、関連会社の製品の整理統合を進め、2002年度までに順次、現在の13拠点を8拠点到集約します。
- ・DRAMの生産拠点である日立日鉄半導体(シンガポール)社では、生産量を需要に見合った規模に絞り込みます。なお、DRAM事業についてはエルピーダメモリ㈱の開発、設計、製造、販売の一貫体制を確立の上、業績の回復とともに同社の株式公開を目指します。
- ・人員については、他事業グループへの異動を含め国内連結ベースで本年度末までに約2,000人削減します。これにより、設備投資圧縮による償却費の削減とあわせ固定費を20%削減します。なお、本年度の設備投資は600億円を見込んでいます。

2. ディスプレイ事業

ブラウン管事業

パソコンモニター用ブラウン管(CDT)事業については既に撤退を決定し、本年末までに国内外における生産を停止するとともに、売却の具体的交渉を進めています。CDT事業からの撤退によって、本事業で生じていた赤字の解消を図るとともに、約2,600人の人員を削減します。

さらに、テレビ用ブラウン管事業についても事業再編を検討していきます。

フラットパネルディスプレイ事業

今後、ディスプレイ事業は、低温ポリシリコンを含むTFT液晶を中心とするフラットパネルディスプレイ(FPD)に経営資源を集中していきます。

従来は、ノートPC向けを中心にFPD事業を拡大してきましたが、今後は、モニター向け大型、携帯電話向けを中心とする中小型についても、当社の有する先端技術を適用した競争力のある新製品を市場投入して積極的な事業拡大を図ります。生産面では、本年7月に世界最大のガラス基板(730mm×920mm)を使用する高効率生産ラインでの生産を、また8月には、中国でのモジュール工程生産を開始するなど原価低減を積極的に進めています。これらの施策により、経営効率の向上と収益の改善を図ります。